

UVA 88C 紫外固化胶 产品数据表

卓越的可靠性

优异的低温固化性能

易于返修

简介

UVA 88C 为一种双固化型紫外胶粘剂，设计用于角部加固及替代传统底部填充材料的高可靠性增强应用，可实现高产能与低成本。该材料可在室温条件下直接施用，无需对基板进行预热。固化后，封装胶层无空洞 (Void-free)，且已固化的 UVA 88C 可轻松返修。UVA 不仅可作为 CSP、BGA、PoP、LGA 以及 Flip Chip 应用中的底部填充替代材料。同时也适用于多种先进封装中的裸芯片保护，例如 Memory Card、Chip Carrier、Hybrid Circuit 及 MCM 等。该产品面向高产能、环保型制造环境设计，在制程速度和抗机械冲击性能为关键考量的应用中表现突出。UVA 88C 易于点胶，可有效降低封装过程中引入的应力，在可靠性 (如温度循环性能) 及机械抗冲击性能方面表现优异。与采用焊膏的方案相比，其跌落测试性能提升达两个数量级。

物理特性

产品名称	UVA 88C 胶粘剂
外观	黑色
未固化材料性能	
项目	数值
比重 (ASTM D1475-60)	1.08 g/cc
粘度 (Brookfield, 0.5 rpm)	15 – 50 k cP
毛细管流速 (STM 777)	室温下填充
固化材料特性	
Tg (ASTM D3418-82)	58 – 79 °C
C.T. E (ASTM E 831), PPM/°C	$\alpha_1 = 75; \alpha_2 = 182$

剪切强度 (FR4 / FR4)	2000 psi
提取离子(MIL-STD-883E)	
Na ⁺	< 5 ppm
K ⁺	<5 ppm
F ⁻	< 5 ppm
Cl ⁻	< 10 ppm
表面绝缘电阻(J-STD-004)	通过 (Pass)

推荐固化条件

UVA 88C 在暴露于 365 nm 紫外光源 (“H”灯)、功率 365 W/inch、光强 2 – 5 W/cm² 条件下，可在数秒内完成固化。对于组装件中未被紫外光直接照射的遮蔽区域，可在所需温度下通过二次热固化实现完全固化。

热固化工艺

可根据制程需求选择以下热固化条件之一：

110 °C × 30 分钟

120 °C × 15 分钟

150 °C × 5 分钟

储存与保质期

在 25 °C 以下条件下，若材料存放于密封的原始包装容器中，保质期为 6–9 个月。超过该期限存放，产品粘度可能会升高。储存过程中应避免 水分侵入、溶剂挥发及异物污染，否则可能对材料的加工性能产生不利影响。

安全

UVA 88C 为环境友好、无毒材料。在操作和使用过程中，仍建议遵循常规的工业卫生操作规范。有关更详细的安全信息，请参阅本产品的 SDS(安全数据表)。

包装

UVA 88C 黏合劑有售 10 cc 和 30 cc。亦可根据客户需求提供其他包装形式。订购及相关信息请联系 YINCAE。